

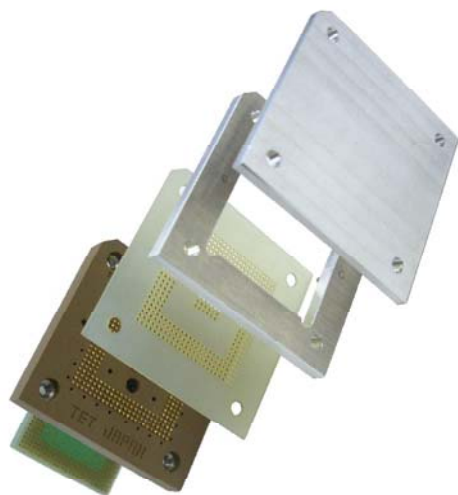
# BGA ソケットシリーズ

## BGAソケットシリーズの製品概要

東京エレテック(TET)のBGAソケットシリーズは、BGA実装部がポゴピン(可動ピン)になっており、半田実装せずにBGAを搭載することができます。

BGA、LGA等のパッケージに対応する表面実装タイプで、エミュレータケーブルや基板と接続することもできます。

特殊形状、多ピン、極小ピッチ等に対応したカスタム製品の開発も承ります。



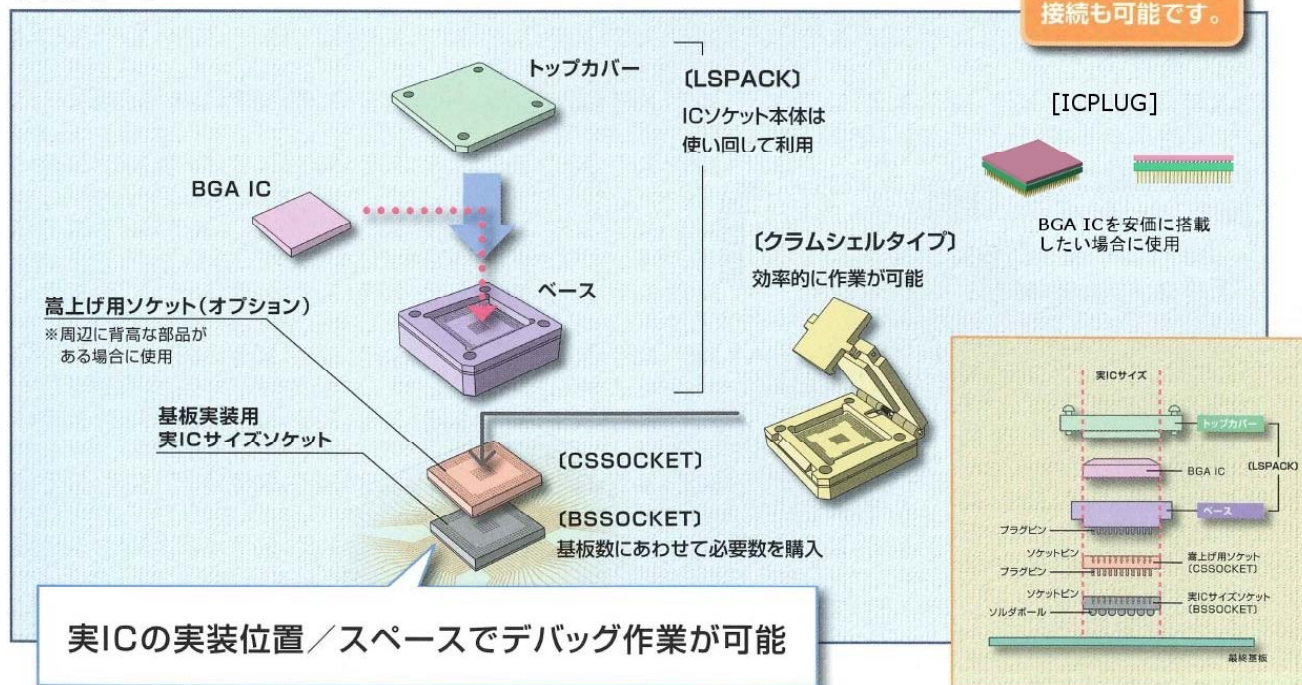
### ■ LSPACK

#### BGAと同じサイズのソケットと組み合わせて搭載できるソケット



- BGAと同サイズのTET製ソケット『BSSOCKET』、または『CSSOCKET』と組み合わせることで、ターゲット基板の周辺に背高な部品がある場合でも高さを稼げるので、周辺に部品を配置できます。
- 狭ピッチに対応しています(0.4mmピッチまで対応可能)。
- BGAを直接搭載したTET製『ICPLUG』を使用することで『BSSOCKET』に直接嵌合できるので、ICソケットが不要となり、コストを低減できます。

#### ● 使用イメージ





## ■ DSPACK

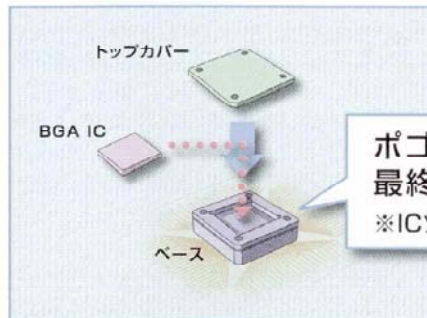
### 半田実装がいない、ポゴピンタイプのBGAソケット



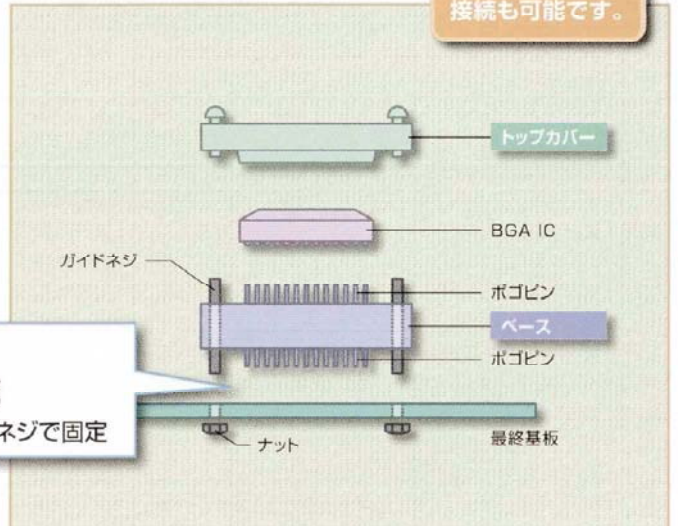
『DSPACK』は、ターゲット基板側もBGAと同じフットパターンのポゴピンになっているので、半田実装が不要です。

● 使用イメージ

エミュレータとの接続も可能です。



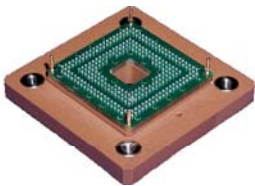
ポゴピンで  
最終基板と接続  
※ICソケットはガイドネジで固定



※基板に固定用のネジ穴を開ける必要があります。

## ■ CSPACK

### 半田ボール付きBGAソケット

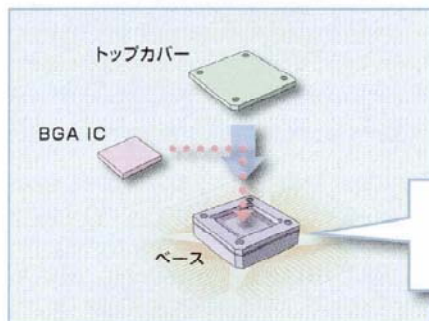


『CSPACK』は、BGAと同じフットパターン状の半田ボールを有することで、リフロー実装が可能です。

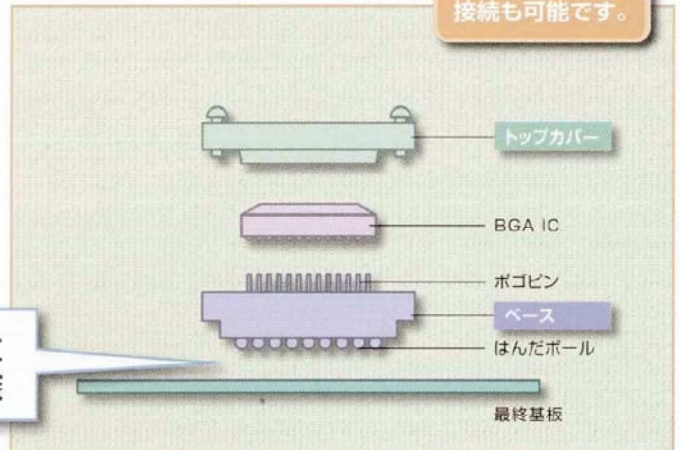
『LSPACK』と『BSSOCKET』の組合せより低コストで基板に実装できます。

● 使用イメージ

エミュレータとの接続も可能です。



最終基板に  
はんだ実装



※0.65mmピッチまで対応(狭ピッチには使用できません)。

また、1000ピン以上では、熱回りに問題が有り、実装が困難となります。

製造・販売元

**TET** 東京エレテック株式会社  
TOKYO ELETECH CORPORATION

〒110-0006 東京都台東区秋葉原3-10  
TEL : 03-5295-1661 FAX : 03-5295-1775  
Email : tet-info@tetco.jp

<http://www.tetco.jp>

Ver.1.01